

第83期 報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで



新光電気工業株式会社

証券コード6967



株主の皆様には、平素よりひとかたならぬご支援を賜り厚く御礼申しあげます。第83期報告書をお届けするにあたり、一言ご挨拶申しあげます。

代表取締役会長兼社長

豊木 則行



エレクトロニクス化が一層進展する自動車や急速な拡大が想定されるIoT関連市場、また、人々の健康を支える医療分野など、半導体は、その頭脳として用途を広げ、今後も市場を拡大することが見込まれています。さらに、ビッグデータ、人工知能（AI）などの広がりが、経済や社会の仕組みに変化をもたらし、これまでとは次元の異なるイノベーションを生み出す可能性を秘めており、半導体は、その可能性を実現するキーテクノロジーとして革新を続けていくことが期待されています。

当社グループは、半導体デバイスの優れた機能を人々の生活のなかへともたらしインターコネクテクノロジーをベースに、高い競争力を持つ製品の開発に努め、ものづくりの革新に継続的に取り組んでまいります。また、お客様のニーズを

的確に把握し、「品質・コスト・納期」を高次元で確立することにより、お客様にとって価値の高い製品・サービスをご提供することに努め、その成功を支え、信頼にお応えするとともに、それらの取り組みを通じて自らの発展・成長を目指してまいります。

さらに、当社グループの企業理念・指針である「SHINKO Way」の実践を通じ、持続的に企業価値を向上させ、社会の健全な発展に寄与するとともに、社会において必要とされる企業であり続けるべく、事業を展開してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

平成30年6月

■ 平成29年度の事業概況

当期の半導体業界は、IoT活用の進展等に伴うメモリー需要の増大や、エレクトロニクス化がさらに進む自動車向けの拡大が半導体市場を牽引した一方で、スマートフォンの成長鈍化やパソコン市場縮小等の影響を受けました。

このような環境の下、当社グループでは、成長市場向けに引き続き重点的に経営資源を投下し、生産体制の充実・強化ならびに市場ニーズに即した新製品の開発・量産化を推進した結果、半導体製造装置市場向けセラミック静電チャックは受注が大幅に増加し、リードフレームは自動車向けを中心に増収となり、プラスチックBGA基板はメモリー向け等に売上が大きく拡大しました。一方、IC組立は、ハイエンドスマートフォン向けが需要変動の影響を大きく受け、フリップチップタイプパッケージは、パソコン市場縮小等により減収となりました。これらにより、当期の連結売上高は1,471億13百万円（対前期比5.2%増）となりました。収益面については、第4四半期において円高・ドル安進展の影響を受けたものの、高付加価値製品の増収効果などにより、経常利益は57億30百万円（対前期比65.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は36億64百万円（同21.9%増）となりました。

単独決算につきましては、売上高1,394億64百万円（対前期比5.3%増）、経常利益54億66百万円（同68.3%増）、当期純利益35億2百万円（同10.4%増）を計上いたしました。なお、当期の配当につきましては、期末配当金を12円50銭とし、中間配当金の12円50銭とあわせて年間25円とさせていただきます。

■ 今後の見通し

今後の半導体業界は、自動運転技術の進展等を背景にエレクトロニクス化がさらに進む自動車向けや、さまざまな分野において活用が加速するIoT・人工知能関連市場向けなど、今後も半導体需要は大きく増加することが想定される一方、これら成長分野においては、多くの企業が参入し、競争は一層激化することが見込まれます。

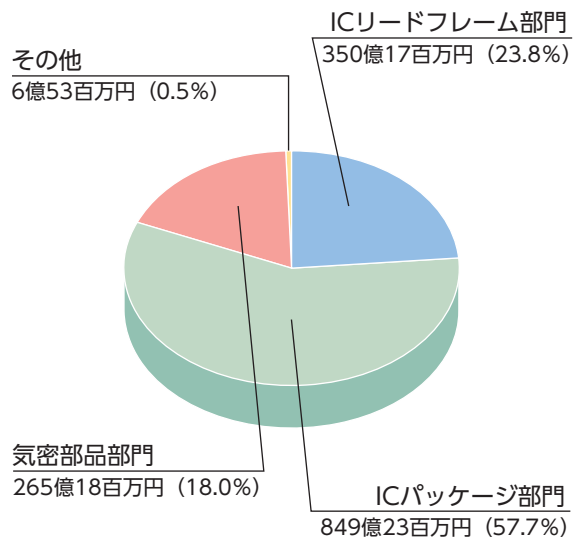
このような環境の下、当社グループは、これまで培ってまいりました半導体実装技術をもとに、高い成長が見込まれる市場向けに重点的に経営資源を投下し、新たな成長に向けた取り組みをさらに強化してまいります。

半導体の高機能化・高速化に対応する次世代フリップチップタイプパッケージは、サーバー用をはじめとして、高性能半導体向けに需要拡大が見込まれることをふまえ、高丘工場（長野県中野市）において生産ライン増強のための設備投資を実施するとともに、また、セラミック静電チャックは、新井工場（新潟県妙高市）において稼働を開始した新工場の量産体制整備を実施するなど、生産能力拡充をはかってまいります。加えて、エレクトロニクス化が一層進展する自動車向けや、半導体市場の成長を牽引するメモリー市場向けに、新製品の開発・量産化ならびに拡販に注力するなど、事業基盤を一層強化し、今後の発展を目指してまいります。

当社グループは、常にお客様のニーズを起点とし、開発、製造、販売各機能の充実・強化に努め、お客様にとって価値の高い製品・サービスを提供することを通じ、市場の成長・拡大を当社の成長に繋げ、「限りなき発展」を果たしてまいる所存であります。

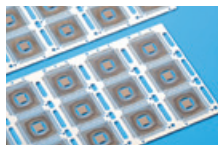
部門別の状況

部門別売上高構成



※ () 内の数字は構成比率を表わしております。

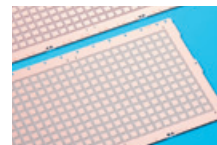
ICリードフレーム部門



プレスリードフレーム



かしめリードフレーム



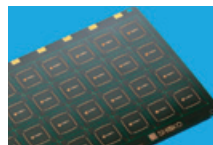
QFNタイプ
リードフレーム

搭載製品例 スマートフォン、自動車、パソコン、家電・産業用他

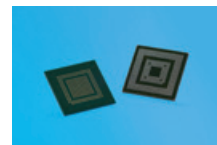
ICパッケージ部門



フリップチップタイプ
パッケージ



プラスチック
BGA基板



IC組立

搭載製品例 パソコン、サーバー、スマートフォン、民生機器他

気密部品部門



セラミック
静電チャック



光学機器用ガラス端子



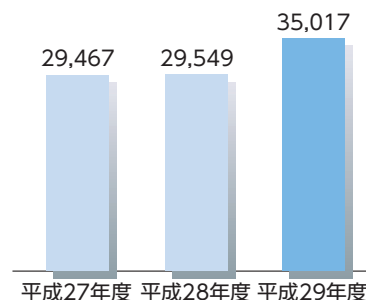
光通信用ガラス端子

搭載製品例 半導体製造装置、自動車、民生機器、通信機器他

売上高 **350億17百万円**（前期比 **↑ 18.5%**）

プレスリードフレームは、エレクトロニクス化がさらに進む自動車向けを中心に需要が拡大し、生産体制を強化したことなどにより、売上が大きく増加しました。エッチングリードフレームは、スマートフォンをはじめ、幅広い用途において旺盛な需要が続くQFN（クワッド・フラット・ノンリード）タイプが堅調に推移したことなどにより、増収となりました。この結果、当部門の売上高は350億17百万円（対前期比18.5%増）となりました。

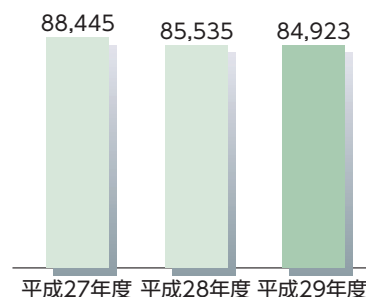
部門別売上高（百万円）



売上高 **849億23百万円**（前期比 **↓ 0.7%**）

プラスチックBGA基板は、スマートフォン等のメモリー向けや自動車向けに受注が大きく増加し、CPU向けヒートスプレッダーもサーバー向けなどに増収となった一方で、フリップチップタイプパッケージは、パソコン市場縮小等の影響により、減収となりました。IC組立においては、自動車向けが好調に推移しましたが、ハイエンドスマートフォン向けが需要変動の影響を受け、受注が減少しました。この結果、当部門の売上高は849億23百万円（対前期比0.7%減）となりました。

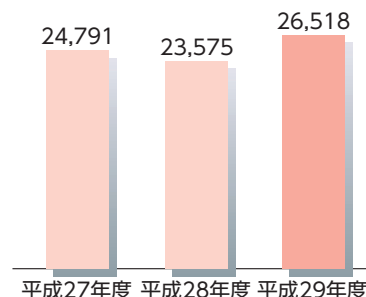
部門別売上高（百万円）



売上高 **265億18百万円**（前期比 **↑ 12.5%**）

半導体製造装置向けセラミック静電チャックは、旺盛な受注環境が継続するとともに、新井工場（新潟県妙高市）新工場が稼働を開始するなど生産能力の増強をはかったことなどにより、売上は大幅に増加しました。光素子用ガラス端子は、光学機器向けに受注が増加しましたが、光通信向けは低調なまま推移しました。この結果、当部門の売上高は265億18百万円（対前期比12.5%増）となりました。

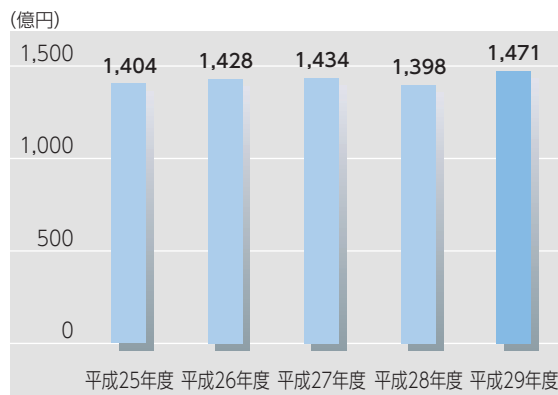
部門別売上高（百万円）



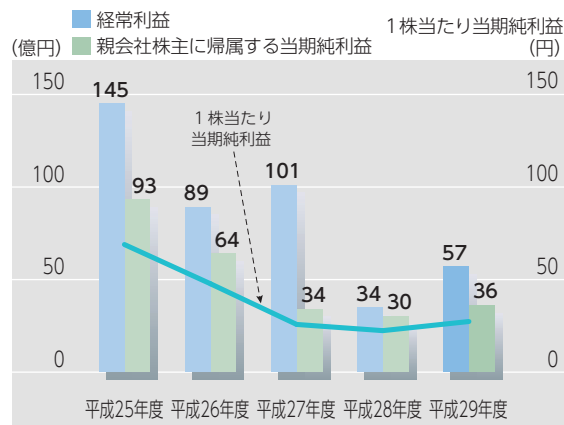
業績の推移

〔連結〕

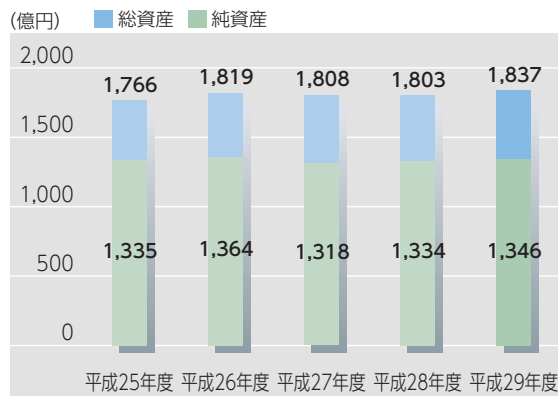
■ 売上高



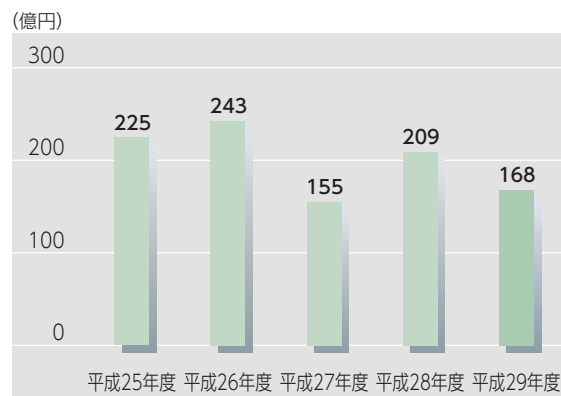
■ 経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益



■ 総資産／純資産

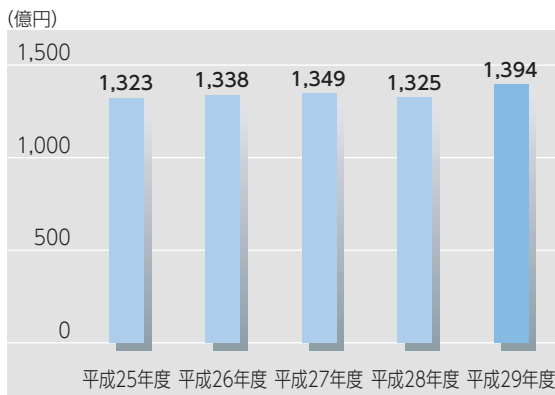


■ 設備投資

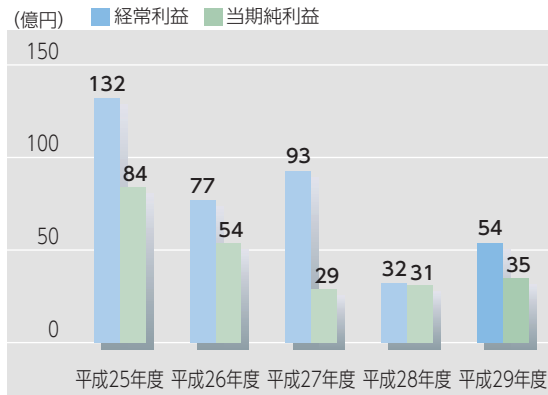


〔単独〕

■ 売上高



■ 経常利益／当期純利益



■ 営業成績および財産の状況の推移

区 分	年 度	平成25年度 〔第79期〕	平成26年度 〔第80期〕	平成27年度 〔第81期〕	平成28年度 〔第82期〕	平成29年度 〔第83期 (当期)〕
〔連結〕						
売 上 高 (百万円)		140,412	142,815	143,453	139,890	147,113
経 常 利 益 (百万円)		14,501	8,973	10,135	3,468	5,730
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)		9,309	6,442	3,476	3,007	3,664
1 株 当 た り 当 期 純 利 益		68円91銭	47円69銭	25円74銭	22円26銭	27円13銭
総 資 産 (百万円)		176,651	181,903	180,886	180,339	183,759
純 資 産 (百万円)		133,536	136,407	131,834	133,435	134,606
1 株 当 た り 純 資 産		988円50銭	1,009円75銭	975円90銭	987円75銭	996円42銭
設 備 投 資 (百万円)		22,508	24,324	15,508	20,973	16,813
研 究 開 発 費 (百万円)		4,218	3,946	3,643	3,499	3,440

〔単独〕

売 上 高 (百万円)	132,302	133,898	134,960	132,504	139,464
経 常 利 益 (百万円)	13,280	7,717	9,319	3,247	5,466
当 期 純 利 益 (百万円)	8,435	5,497	2,958	3,173	3,502

決算概要（連結）

Financial Statements(Consolidated)

■ 連結貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
資 産 の 部	183,759	180,339
流 動 資 産	105,265	101,273
固 定 資 産	78,494	79,066
有 形 固 定 資 産	72,464	72,633
無 形 固 定 資 産	1,237	1,197
投資その他の資産	4,792	5,235
資産合計	183,759	180,339

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
負 債 の 部	49,152	46,904
流 動 負 債	36,947	34,154
固 定 負 債	12,205	12,749
純 資 産 の 部	134,606	133,435
株 主 資 本	144,110	143,822
資 本 金	24,223	24,223
資 本 剰 余 金	24,129	24,129
利 益 剰 余 金	95,850	95,562
自 己 株 式	△ 92	△ 92
その他の包括利益累計額	△ 9,504	△ 10,387
負債純資産合計	183,759	180,339

■ 連結損益計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
売 上 高	147,113	139,890
売 上 原 価	129,704	124,222
売 上 総 利 益	17,409	15,668
販売費及び一般管理費	12,510	12,399
営 業 利 益	4,899	3,268
営 業 外 収 益	847	638
営 業 外 費 用	15	438
経 常 利 益	5,730	3,468
特 別 損 失	895	434
税金等調整前当期純利益	4,834	3,034
法人税、住民税及び事業税	1,395	491
法 人 税 等 調 整 額	△ 225	△ 464
親会社株主に帰属する当期純利益	3,664	3,007

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,806	20,489
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,273	△ 17,653
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,441	△ 3,444
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 673	△ 499
現金及び現金同等物の増減額	△ 1,581	△ 1,107
現金及び現金同等物の期首残高	47,248	48,355
現金及び現金同等物の期末残高	45,666	47,248

次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化

当社のフリップチップタイプパッケージは、半導体の微細化、高密度化に対応し、電気特性・耐熱性に優れた半導体パッケージとして、パソコン、サーバーに搭載されるCPU等の高性能半導体向けに数多く使用されています。

今後、半導体市場は、IoT、人工知能（AI）の活用の進展や、自動運転の実用化に向けた展開等を背景としてさらに拡大し、大容量のデータを高速で処理するサーバー向けをはじめとして、高性能半導体の需要も一層高まることが想定されます。

当社は、これらのニーズに対応する次世代フリップチップタイプパッケージの生産体制強化をはかるため、高丘工場（長野県中野市）において生産ラインの導入等を行ってまいります。



生産ライン導入予定の高丘工場J棟

新光エレクトロニクス・マレーシアにおいて生産能力を增強



新光エレクトロニクス・マレーシア

マレーシアの首都・クアラルンプール近郊に位置する新光エレクトロニクス・マレーシアは、自動車向けをはじめとするリードフレームの旺盛な需要に対応するため、めっきライン、ユーティリティ設備の增強等を実施し、生産能力の拡充をはかっています。

これまで長年にわたり培ってきたプレス、めっき等のテクノロジーを基盤とするリードフレームは、高い信頼性が要求される自動車向けに数多く採用されており、自動車のエレクトロニクス化の進展を背景に、今後、さらなる需要増加が見込まれます。

同社は、1992年の操業開始以来、精密金型を用いたプレスリードフレームを製造してまいりましたが、数多くのお客様が展開する東南アジア地域の生産拠点として、そのニーズにお応えするべく、充実・強化に努めてまいります。

会社の概要

Corporate Data

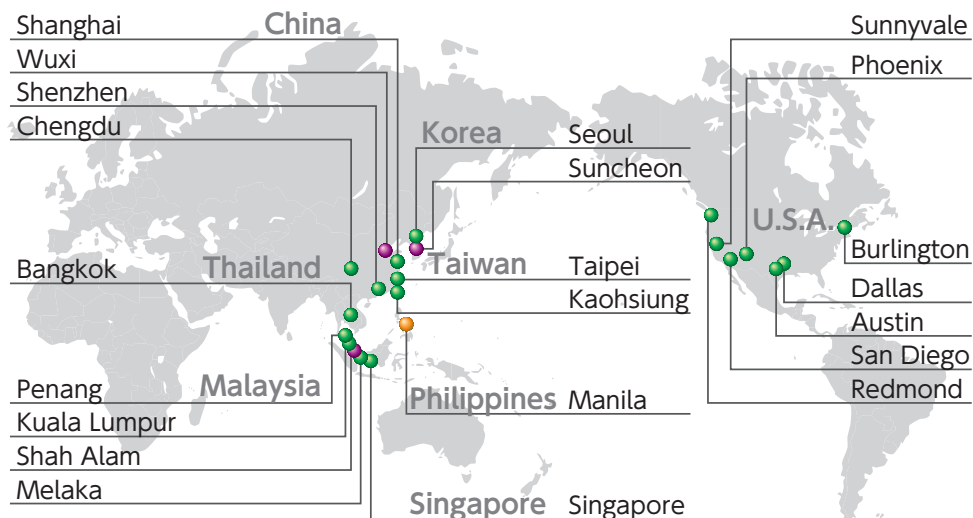
(平成30年3月31日現在)

取締役

(平成30年6月26日現在)

- 商 号 新光電気工業株式会社
- 設立年月日 昭和21年9月12日
- 本 社 長野県長野市小島田町80番地
電話 (026) 283-1000 [代表]
- 主な事業内容 リードフレーム、プラスチック・ラミネート・
パッケージ、ガラス端子などの製造・販売、
ICアSEMBリ
- 従業員数 3,987名 (連結4,785名)
- 工場等 更北、若穂、高丘、新井、京ヶ瀬、
新光開発センター、栗田総合センター
- 営業所等 東京、大阪、仙台、長野、名古屋、大分、福岡、
マニラ
- グローバルネットワーク

代表取締役会長兼社長	豊 木 則 行
代表取締役 専務執行役員	長 谷 部 浩
取 締 役 常務執行役員	小 平 正 司
取 締 役 常務執行役員	小 澤 隆 史
取 締 役 常勤監査等委員	伊 藤 明 彦
取 締 役 監査等委員	北 澤 光 二
取 締 役 監査等委員	荒 木 泉 子



● 営業拠点 ● 駐在員事務所 ● 生産拠点

株式の状況

Shareholders' Data

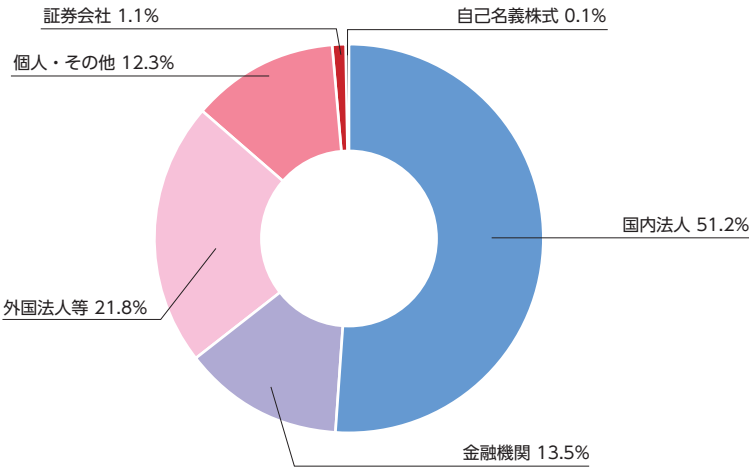
(平成30年 3月31日現在)

■発行可能株式総数	540,000,000株	■資本金	24,223,020,480円
■発行済株式の総数	135,171,942株	■株主数	14,045名
■大株主			

株主名	所有株式数 (千株)	出資比率 (%)
富士通株式会社	67,587	50.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	4,112	3.04
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	3,809	2.82
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	3,238	2.40
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	2,484	1.84
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	2,077	1.54
株式会社八十二銀行	1,836	1.36
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	1,631	1.21
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	1,567	1.16
新光電気工業株式会社従業員持株会	1,499	1.11

所有者別株式分布状況

(平成30年 3月31日現在)



株式事務のご案内

■株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関

(連 絡 先) 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町 1-1
電話 0120-232-711 (通話料無料)

(郵 送 先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

■事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

■基準日

定時株主総会関係
配当金受領株主確定日

3月31日
3月31日および中間配当金の支払いを行う
ときは9月30日

■公告方法

電子公告
当社は、公告を下記ウェブサイトに掲載して
おります。

<http://www.shinko.co.jp/ir/kk/>

ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、配当金の振込みのご指定、買取請求その他の各種
お手続きにつきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券
会社等）にお問い合わせください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
三菱ＵＦＪ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記の連
絡先にお問い合わせください。三菱ＵＦＪ信託銀行全国各支店におい
てもお取り扱いいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払
いたします。



新光電気工業株式会社

〒381-2287 長野県長野市小島田町 80 番地
電話(026)283-1000〔代表〕FAX(026)284-8861
<http://www.shinko.co.jp>



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。



地球環境に配慮した植物油
インキを使用しています